



#### RE900-02

- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Zweiseitig 35 µm Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Oberfläche chem. Ni/Au mit Lötstopplack beschichtet
- Adaptionplatine für TSOP I 28, 32, 40, 48 (0,50 mm)
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Gerberdaten zur Herstellung des Lötpastenaufdrucks werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt
- Größe 26,50 x 43,64 mm

Modul-Nr.	Typ	Pitch	Pin	Größe (mm)
RE900-02	TSOP I	0,500 mm	28, 32, 40, 48	12,00 x 20,00